

Bitte
frankieren

Nano-Cluster Bodensee
Frau Evelyne Wohnrau
Lerchenfeldstrasse 5
CH- 9014 St. Gallen

Organisatorisches

Kick-off-Meeting am 17. Juni 2010:

Anmeldung: Mit Anmeldetalon an Frau Evelyne Wohnrau
oder per Email: evelyne.wohnrau@ncb.ch
Tel. +41 (0)71 274 73 81
Fax +41 (0)71 274 73 86
(Anmeldebestätigung erfolgt per Email).

Kosten: CHF 80.- für Teilnehmer, für NCB-Mitglieder frei.

Annullierung: CHF 30.- bei Abmeldung bis 14. Juni 2010
danach die volle Gebühr. Eine Ersatzperson wird
jederzeit akzeptiert.

Bemerkung: Die Teilnahme ist bezüglich Fortsetzung in der
Focusgruppe unverbindlich.

Focusgruppen-Workshops August bis Oktober 2010:

**Vertiefung der im Kick-off-Meeting identifizierten und
festgelegten Focus-Themen.**

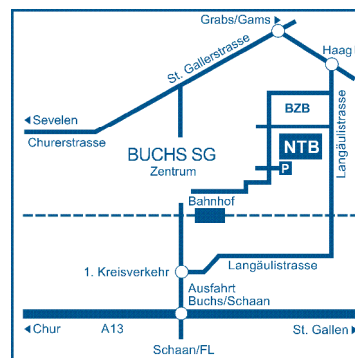
Anmeldung: Im Anschluss an das Kick-off-Meeting
an obige Adresse

Kosten: NCB-Mitglieder: CHF 780.00

Unternehmen aus Beitragskantonen:
(SG, AR, SH) CHF 980.00

Unternehmen aus Nicht-Beitragskantonen:
CHF 1'180.00

NTB Buchs



Anreise mit PKW:

- Autobahn A13, Ausfahrt Buchs / Schaan
- Richtung Buchs beim 1. Kreisell folgen Sie den Wegweisern „NTB / BZB“
- GPS: Werdenbergstr. 4 9470 Buchs

Anreise mit öV:

- 10 Min. zu Fuss ab Bhf Buchs



Nano-Cluster Bodensee



Focusgruppe

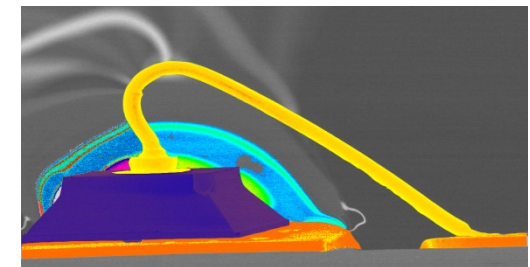
Electronic Packaging

Neue Ansätze
dank Nanotechnologie

- Kick-off-Meeting Donnerstag, 17. Juni
- Trends und Herausforderungen
- Einsatz der Nanotechnologie
- Anforderungen, Perspektiven und Lösungsansätze
- Wie können Unternehmen der Region zu neuen Lösungen kommen?

Donnerstag, 17. Juni 2010 / 14.30 Uhr

Interstaatliche Hochschule für Technik
Buchs NTB, Werdenbergstrasse 4
9470 Buchs / SG



Thema

Das Packaging von elektronischen und optischen Miniaturbaugruppen oder Komponenten wie Sensoren, Aktoren, Halbleiterbauteile, Lab-on-a-Chip, usw. ist für deren Funktionserfüllung entscheidend.

Die Nachfrage nach funktionalen Packages nimmt zu. Damit steigen auch die Anforderungen einerseits an deren Funktionen, die weit über Schützen, Halten und Verbinden hinausgehen und andererseits an Qualität, Herstellbarkeit und Kosten.

Innovative Packages müssen produktspezifisch entwickelt werden – es entstehen neue Herausforderungen und Fragestellungen, wie zum Beispiel:

- geeignete Werkstoffe für die Verbindungs- und die Schutztechnik
- Material- und Oberflächenpaarungen
- Wärmemanagement
- Fehleranalytik in der Verbindungstechnik.

Die **Nanotechnologie** bietet neue Ansätze zur Lösung dieser Fragestellungen und zur Entwicklung neuer Funktionalitäten. Speziell interessant sind Ansätze, welche als Plattform für eine ganze Kategorie von Problemstellungen eine Lösung bieten.

Der Nano-Cluster Bodensee (NCB) bringt Ihnen die Möglichkeiten der Nanotechnologie näher und fördert deren Nutzen bringende Anwendung.

In **Focusgruppen** erarbeiten interessierte Unternehmen gemeinsam konkrete Fragestellungen und Lösungsansätze. Diese können darauf je nach Bedarf in Kooperationsprojekten realisiert werden.

Ziele sind die industrielle Produktion wettbewerbsstarker Produkte und Prozesse.

Programm

Focusgruppe Electronic Packaging

- | | |
|------------|--|
| 17. 06. 10 | Kick-off-Meeting: Einführung, interessierende Themenbereiche |
| Aug. 2010 | 1. Workshop: Nanotechnologische Hebel |
| Sept. 2010 | 2. Workshop: Eingrenzung Themenbereich, konkrete Fragestellung |
| Okt. 2010 | 3. Workshop: Lösungsansatz, Vorgehensweise |

Kick-off-Meeting 17. Juni 2010

Ziel: Die Teilnehmenden erhalten einen Einblick in das Thema und die Vorgehensweise. Entscheidungsgrundlagen für weitere Teilnahme. Erfahrungsaustausch.

Programm:

- | | |
|-------|--|
| 14.30 | Begrüßung NCB und NTB |
| 14.50 | Einführungsreferat:
Device Packaging:
Aktuelle Fragestellungen und Ausblick in die Zukunft
Herausforderung Miniaturisierung und Kostendruck
Nanotechnologische Lösungsansätze
Stand der Technik und Perspektiven

Prof. Dr. André Bernard, Dipl. Ing. FH Dietmar Bertsch,
Institut für Mikro- und Nanotechnologie MNT,
Interstaatliche Hochschule für Technik NTB, Buchs SG |
| 15.30 | Impulsreferat 1:
State-of-the-art Electronic Packaging für komplexe Nischenanwendungen

Dr. Nico Onda, Altatec Microtechnologies AG, Steinhausen |
| 15.55 | Kaffeepause |
| 16.25 | Impulsreferat 2:
Packaging - das zukünftige Rückgrat der Computerindustrie

MSc. Tobias Lamprecht, IBM Research, Rüschlikon |
| 16.50 | Plenardiskussion

Ansatzpunkte aus den vertretenen Unternehmen.
Nutzen und Chancen neuer Ansätze in der Wertschöpfungskette. Ansatzpunkte und Fragenbereiche für die Focusgruppe. |
| 17.20 | Nächste Schritte der Focusgruppe |
| 17.30 | Besichtigung Institut Mikro- und Nanotechnologie |
| 18.00 | Apéro |

Zielpublikum

Hersteller von „Electronic Devices“ wie Sensoren, Miniaturbaugruppen, Aktoren, Photonics-Elementen, Hörgeräten, usw.

Hersteller von Packaging-Komponenten wie PCBs, Stecker, Anzeigeelemente, Durchführungen, usw.

Technologieanbieter von z.B. Klebetechnik, Oberflächentechnik

Geschäftsleitung, Entwicklung, Engineering, Produktion, Product Management und Marketing sowie Vertreter der Wissenschaft.

Anmeldung Teilnahme Kick-Off



Electronic Packaging

Neue Ansätze dank Nanotechnologie

Ich melde mich zum Kick-off-Meeting an
(Anmeldeschluss: 11. Juni 2010)

Name/Vorname

Funktion

Firma

Strasse

PLZ/Ort

Tel.

Fax

E-Mail

Unterschrift
